

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年9月26日(26.09.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/195644 A1

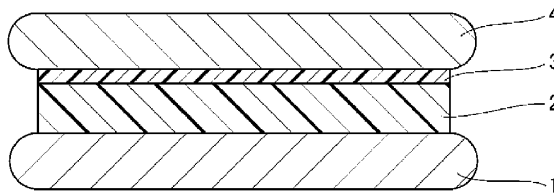
- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) H01L 21/02 (2006.01)
C09D 5/20 (2006.01) H01L 21/683 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/009720
- (22) 国際出願日: 2024年3月13日(13.03.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-046679 2023年3月23日(23.03.2023) JP
- (71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者: 柳 生 雅 文 (YAGYU Masafumi); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).
新城 徹也(SHINJO Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).
- (74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-

- 4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 IP特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) Title: RELEASE AGENT COMPOSITION FOR PHOTOIRRADIATION RELEASE, LAYERED PRODUCT, AND METHOD FOR PRODUCING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 光照射剥離用の剥離剤組成物、積層体、及び加工された半導体基板の製造方法



(57) Abstract: This release agent composition for photoirradiation release is a release agent composition which contains a polymer and a solvent. The polymer has a first structure, a second structure, and a third structure. The first structure has a structure which absorbs light and imparts releasability to a release agent layer formed from the release agent composition. The second structure has a -Si-O-Si- structure in the main chain of the polymer. The third structure has an aromatic hydrocarbon ring and/or a heterocyclic ring.

(57) 要約: 光照射剥離用の剥離剤組成物であって、ポリマーと、溶媒とを含有し、前記ポリマーが、第1構造と、第2構造と、第3構造とを有し、前記第1構造が、光を吸収して、前記剥離剤組成物から形成される剥離剤層に剥離性を付与する構造を有し、前記第2構造が、前記ポリマーの主鎖中に-Si-O-Si-構造を有し、前記第3構造が、芳香族炭化水素環及びヘテロ環の少なくともいずれかを有する、剥離剤組成物。

[続葉有]



WO 2024/195644 A1

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）